

ESWIN

北京奕斯伟科技集团有限公司（简称“ESWIN”），是一家半导体领域产品和服务提供商，核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、好封测三大领域。

芯片与方案事业围绕移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景，为客户提供显示与视频、智慧连接、智慧物联和智能计算加速等四类芯片及解决方案。

硅材料事业主要包括12英寸全球好制程硅单晶抛光片和外延片。好封测事业主要包括芯片后端封测、COF卷带、面板级集成封测三类业务。

奕斯伟集团拥有全球半导体领域经验丰富的技术研发和经营管理团队，总部位于北京，在北京、海宁、合肥、成都、西安、英国南安普顿、韩国首尔等地设有研发中心，在西安、成都、合肥、苏州等地拥有制造基地，在香港、广州、深圳、南京、上海、中国台湾、美国硅谷、韩国首尔等地设有营销据点。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/eswin-109668.html>